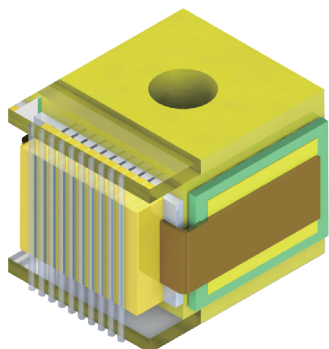


GS06传导冷却 半导体激光器阵列



GS06封装形式的半导体激光器阵列是杏林睿光开发的一款高温（60℃）下使用的小型化、多波长产品，亦可单一波长输出，巴条长度5mm，单巴条功率150-200W，可封装15个巴条。该结构带有快轴压缩（FAC），快轴发散角 $\leq 8^\circ$ 。其它波长、封装形式可接受定制。

主要功能特点

- ◆ 硬焊料封装
- ◆ 结构紧凑
- ◆ 高峰值功率密度
- ◆ 高可靠性

应用

- 激光泵浦
- 激光照明
- 激光加工
- 科学研究

技术参数

光学参数	
型号	Rxxx±5-Q1800-GS06-5*9
中心波长 λ_c (nm)	796~808
中心波长范围 $\delta\lambda_c$ (nm)	±5
每Bar输出功率 (W)	200
Bar数量	9
Bar间距 (mm)	~0.6
光谱宽度 (FWHM) (nm)	<5
每Bar斜率效率 (W/A)	>1.0
快轴发散角 (FWHM) ($^\circ$)	8
慢轴发散角 (FWHM) ($^\circ$)	12
波长温度漂移系数 (nm/ $^\circ$ C)	~0.3
电学参数	
电光转换效率 (%)	>48
阈值电流 I_{th} (A)	<27
工作电流 I_{op} (A)	<170
工作电压 V_{op} (V)	<2.1
占空比 (%)	<0.8
脉冲宽度 (μ s)	<300
重复频率 (Hz)	<30
热学参数	
工作温度范围 ($^\circ$ C)	-40~75
储存温度范围 ($^\circ$ C)	-45~80

注：1. 不同参数请咨询销售经理。

2. 如果超过正常工作范围使用，器件寿命可能会缩短。

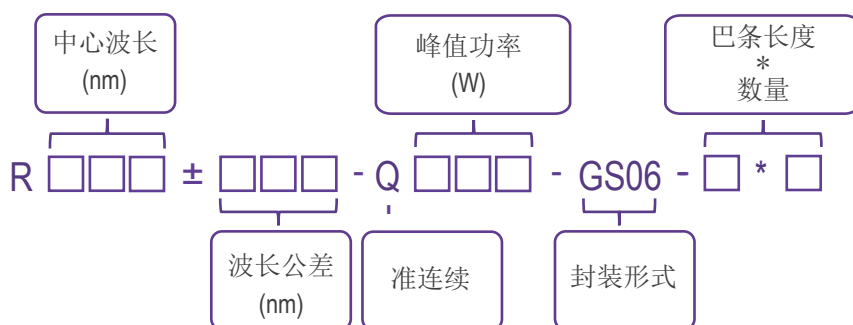
3. 器件工作或储存环境需保证不结露。

4. 以上参数测试条件：QCW。

产品型号一览表

封装形式	中心波长 (nm)	峰值功率 (W)	型号
GS06	796~808	1800	Rxxx±5-Q1800-GS06-5*9

产品型号命名规则



机械尺寸图 单位：mm

